

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月27日(27.07.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/140344 A1

- (51) 国際特許分類:
CIID 1/62 (2006.01) *G03F 7/42* (2006.01)
CIID 3/20 (2006.01) *H05K 3/06* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/001639
- (22) 国際出願日: 2023年1月20日(20.01.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-008168 2022年1月21日(21.01.2022) JP
- (71) 出願人: 関東化学株式会社(KANTO KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 伊藤 翼(ITO, Tsubasa); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP). 佐々木 遼(SASAKI, Ryo); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP). 清水 寿和(SHIMIZU, Toshikazu); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 葛 和 清 司 (KUZUWA, Kiyoshi); 〒1600023 東京都新宿区西新宿6丁目2 4

番1号西新宿三井ビルディング17階 葛和国際特許事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: PHOTORESIST REMOVER COMPOSITION

(54) 発明の名称: フォトレジスト剥離組成物

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a photoresist remover composition which has the high ability to remove cured resists and is effective in inhibiting the corrosion of substrate-constituting metals in contact therewith, such as Cu and Al, and in inhibiting the Cu and other metals from being excessively oxidized during the removal process. This photoresist remover composition comprises (A) a quaternary ammonium hydroxide, (B) diethylene glycol monoethyl ether, (C) glycerin, and (D) water, wherein the content of (A) is 0.5-5 mass% with respect to the whole mass of the composition, the content of (B) is 50-95 mass% with respect to the whole mass of the composition, the content of (C) is 0.5-20 mass% with respect to the whole mass of the composition, and the content of (D) is less than 20 mass% with respect to the whole mass of the composition.

(57) 要約: 本発明は、硬化したレジストに対しても高い剥離性を示し、CuおよびAlなどの接液する基板構成金属の腐食を抑制し、剥離プロセス中のCuなどの金属の過剰な酸化を抑制することのできるフォトレジスト剥離組成物を提供することを課題とする。フォトレジスト剥離組成物であって、組成物が、(A) 四級アンモニウムヒドロキシド、(B) ジエチレングリコールモノエチルエーテル、(C) グリセリン、および、(D) 水を含み、(A) の含有量が、組成物の全質量に対して0.5~5質量%であり、(B) の含有量が、組成物の全質量に対して50~95質量%であり、(C) の含有量が、組成物の全質量に対して0.5~20質量%であり、(D) の含有量が、組成物の全質量に対して20質量%未満である、前記組成物により上記課題が達成された。

[続葉有]

WO 2023/140344 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）